

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 | ✓分析师会议 |
| | <input type="checkbox"/> 媒体采访 | <input type="checkbox"/> 业绩说明会 |
| | <input type="checkbox"/> 新闻发布会 | <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| | <input type="checkbox"/> 现场参观 | ✓一对一沟通 |
| | ✓其他（电话会议） | |
| 参与单位 及人员 | 易方达基金、海富通基金、华商基金、国新投资、兴业证券、东吴基金、盛宇投资、熵盈私募光大保德信基金、上海国资公司、建信基金、汇丰晋信基金、东方资管、长盛基金、鹏华基金、嘉实基金、长信基金、东方基金、中银基金、西部利得基金、睿郡资产、华泰资产、广发资管、中信资管、中新融创、宽源投资、向三创投资、拓聚投资、全天候投资、混沌投资、合晟资产、利幄基金、马可波罗、信复创值投资、合众资产、正心谷（檀真）、信达资本、百年资产、中大君悦投资、玄卜投资、万杉资本、英大保险资管、锐天投资、中银理财、中庸资本、泾溪投资、红杉资本、喜世润投资、通用技术（集团）、北京容光投资、昭图投资、招商信诺资产、恒邦兆丰资管、鑫焱投资、吉富创投、禹田资本、万向创投、益和源资产、紫金信托、漳州资本运营、晓角投资、中信证券、中邮证券、东北证券、国泰海通、浙商证券、长城证券、中泰证券、申万宏源、国元证券、国信证券、银河证券 | |
| 时间 | 2026年1月25日 | |
| 地点 | 公司上海办公室 及 线上会议 | |
| 接待人员 | 董事会秘书兼财务总监常亮先生 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、关于2025年业绩预告的说明</p> <p>2025年9月以来，公司市值显著攀升，投资者对公司成长性的期待很高，管理层认为有责任将公司业绩的变化趋势尽量清晰地呈现给市场。业绩预告文件主要披露了4项财务指标，分别是营业收入、净利润、归母净利润、归母扣非净利润。</p> <p>营业收入方面，预告范围为4.3-4.5亿元，同比增长42.04%到48.65%。公司前三季度的单季度平均收入约为1亿元（未经审计），因此第四季度的收入环比增长有望大幅增加。</p> <p>净利润方面，预告范围为1.1-1.3亿元，同比增长135.30%到178.09%。公司前</p> | |

三季度的未经审利润总额约为8,200万元（未经审计），因此第四季度的利润环比有望有所增加。

归母净利润方面，预告范围是0.9–1.1亿元。其与净利润的差异，主要反映了公司硅零部件业务的经营主体所包含的少数股东权益。

归母扣非净利润方面，预告范围是0.88–1.08亿元。基本与归母净利润一致，可以作为公司盈利质量之参考。

以上说明所依据的财务数据（包括前三季度数据），尚未经过注册会计师年审，可能在年报正式发布（3月21日）前发生变化。公司将在2月份发布业绩快报，继续提高业绩清晰度。请投资者自行评估投资风险。

二、净利润同比增长率大幅超过收入增长率的原因

根据预告，净利润的增长幅度有望三倍于收入增长幅度，显示公司具备较强的业绩弹性。管理层认为，主要原因有三点：

第一，公司是具备“从硅材料到硅零部件”一体化完整生产能力的国产厂商。两项业务互相促进，释放了公司的盈利潜力；

第二，公司硅材料业务的开工率提升空间较大，不管是公司硅零部件业务的新增消耗，还是直接对外出售大直径硅材料的增加，都会产生规模效益，有望持续降低成本；

第三，历年数据来看，公司“三费”（销售费用、管理费用、财务费用）相对营业收入的比重较低，营业收入增长对费用增长的敏感性较低。

三、硅零部件业务的增长预期

目前公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了长江存储、长鑫存储等中国主流存储芯片制造厂及北方华创、中微公司等等离子刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用。

从2025年第三季度开始，公司已根据下游需求持续扩产，力争沿着过去数年的发展曲线，确保产能增长和生产良率的最佳平衡。

四、大直径硅材料业务的增长预期

公司大直径硅材料业务的产能和技术实力，处于全球领先位置。公司目前的大直径硅材料产能足以应对潜在市场需求，开工率提升空间较大。2025年12月以来，公司已经收到海外市场新增订单，将密切跟踪海外市场发展态势，及时调整

产能配置。

此外，公司硅零部件业务的快速增长，很大程度上降低了公司大直径硅材料业务对外部周期性市场的依赖，拉动了大直径硅材料业务的开工率，有望扩大规模效益，降低生产成本，增厚公司整体盈利。

五、中国存储芯片产能增长对公司的影响

管理层认为，纵观过去五十余年的全球半导体产业历史，存储芯片作为大宗品，其产能的重心转移，向来是全球芯片制造产能转移的先声——从美国到日本的转移，以日本东芝公司的崛起为标志；从日本到韩国及中国台湾的转移，以韩国三星公司的崛起为标志。

正在发生的第三次转移，很可能以中国存储芯片制造厂商的崛起为标志。最近一个季度，国际领先的存储厂商相继宣布退出消费级存储芯片业务，拱手让出了广阔的全球消费级存储芯片的市场空间，为中国本土存储芯片制造厂商提供了难得的机遇。后者有望发挥中国在消费电子终端、智能网联企业、具身智能机器人等领域的庞大潜力，赢得未来全球市场。此外，中国本土人工智能产业对高端存储芯片产能的渴求，也是中国本土存储芯片的长期发展动力。

综上，有志于成为世界级公司的中国厂商，必须抓住这次产业转移所带来的机会。

公司的大直径硅材料产品及其制成品硅零部件，是高端存储芯片制造所需等离子刻蚀环节中的核心耗材，开工率越高、刻蚀强度和次数越多，消耗量越大。2026年，中国大陆硅零部件市场规模有望达到约70亿元人民币，国产化率尚不足10%。公司将稳扎稳打，力争抓住未来几年中国存储芯片产能大规模建设、国产化率提升的机遇。

六、公司对潜在地缘政治事件的影响评估

公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业，致力于中国集成电路制造核心工艺材料和零部件的国产化建设。目前公司大部分收入来自中国本土市场，已在供应链国产化方面取得长足进展。

当前，中国本土半导体材料和零部件产业仍处于起步阶段，地缘政治事件对供应链的潜在影响既是挑战更是机遇。公司将密切关注事态发展，提前筹划供应链寻源和国产化工作，加强库存管理，争取在未来的国产化浪潮中取得佳绩。

七、公司前次募投项目拟终止对公司业务的影响

公司董事会基于国际国内市场环境变化并综合考虑各方面因素，以保护股东利益和提高资金使用效率为核心，审慎决定不再继续投入原募投项目。该事项尚需2026年第一次临时股东会审议。

本次拟终止的募投项目已实施部分均已顺利落地并形成有效产能，相关产能已正式投入运营，对公司主营业务形成有效补充与协同支撑，为公司产能布局优化及可持续发展奠定了坚实基础，发挥了积极作用。

八、公司的外延式发展战略

纵观国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。

2025年12月，神工股份与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司共同发起设立的产业投资基金已设立并首期缴款完成。

成立该基金，是公司落实外延式发展的诸多路径之一。该基金将结合神工股份的产业优势，重点关注围绕晶圆制造需要的关键设备、零部件、材料等方向进行布局；基金的投资地域重点聚焦于中国境内，兼顾布局全球及投资拥有先进技术、优质产能且有望引进国内的海外优秀标的公司。

公司将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。

九、公司对2026年半导体市场的展望

2024年以来，全球半导体市场有所回暖，但结构性特征却极为显著，且其背后驱动力与以往周期大相径庭：终端需求的来源，并非消费者对智能手机、个人电脑等电子产品的日常消费，而是科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入的资本开支，在产业历史上尚属首次。

因此，半导体各细分市场的景气度高度分化：与消费电子相关的成熟市场仍处于萧条期，而与人工智能相关的新兴高端市场却供不应求，景气度高涨。

公司管理层综合市场研究数据认为：2026年海外科技巨头在人工智能领域的资本开支将超过单季度1,000亿美元，将为本次周期结构性回暖提供强劲动能，建

| | |
|------|---|
| | <p>设庞大的芯片制造产能。因此，本次周期回暖的市场规模峰值有望超过上一周期（2021-2022年）。</p> <p>另一方面，芯片制造产能及其配套的基础设施建设，乃是极为复杂的系统工程，难以一蹴而就，因此海外下游市场需求的释放节奏可望长于上一周期。</p> <p>中国国内市场方面，由于海外厂商退出消费级存储芯片市场的短期刺激，叠加本土人工智能领域长期需求，中国本土存储芯片制造产能有望继续增长；此外，随着海外先进逻辑芯片代工厂削减成熟制程产能，国内逻辑芯片代工厂将获得新的发展动能，以填补其供应缺口，将刺激中国本土逻辑芯片制造产能增长。</p> <p>值得注意的是，当前中国本土芯片设计和制造所需要的工业软件、材料、零部件及关键设备的国产化进程已经进入“深水区”，仍然任重而道远。</p> <p>公司业务同时受益于海外和中国市场需求。公司将紧密跟踪市场变化，积极应对、审慎决策，为股东创造长期价值。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2026 年 1 月 26 日 |